

令和元年 7月18日

NEDIA会員各位

(一社)日本電子デバイス産業協会
事務局次長 小林関司

材料部品部会主催・第二十四回勉強会開催のご案内

盛夏の候、皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。

下記の日程で「第二十四回材料部品部会主催の勉強会」を開催いたします。

今回の勉強会では、最新電子機器の解析による実装技術の動向、ビジネス環境の変化に対応した戦略、半導体産業の現状と今後の動向についての講演をしていただく予定です。

今回、特別講師といたしましてTV雑誌等で大活躍をされております真田家(松代藩)14代目の真田幸光先生をお招きしてお話をさせていただきます。

是非大勢の方のご参加をお待ちしております。

—記—

1. 日時 令和元年9月12日(木)(13:00~16:40)

2. 場所 御茶ノ水めっきセンター4F会議室

東京都文京区湯島1-11-10

03-3814-5621(代)

<http://www.tmk.or.jp/gaiyou.html>

3. 講演スケジュール

(1)(13:00~13:40)

テーマ「実装技術の新潮流 掴めるか日本企業 !!」

講師 加藤 凡典 氏 / (有)AIT代表取締役

(2)(13:40~14:30)

テーマ「メガトレンドの最新情報 !!」

~~AI, IoT, 5G, セキュリティーの動向~~

講師 津田 建二 氏 / (株)セミコンダクタポータル 編集長

休憩時間 (14:30-14:40)

(3)(14:40~16:40)

テーマ「混んとする国際情勢への対応 !!」

~~世界情勢を見極めた今後の企業運営~~

講師 真田 幸光 氏 / 愛知淑徳大学ビジネス学部 教授

(注) ご参加希望の方は添付の用紙にご記入の上、9月 5日までにメールにて事務局宛に返信をお願い致します。定員(60名)になり次第締め切らせていただきます。

以上